

杭州迪普科技股份有限公司

关于公司及子公司分别向金融机构申请授信额度 及为授信额度内贷款提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的议案》，同意根据公司战略发展规划和经营需要，公司及子公司杭州迪普信息技术有限公司拟分别向银行申请授信额度预计合计不超过3.00亿元。公司及子公司根据审核机构要求，分别以各自资产进行担保，包括以土地使用权进行抵押，以知识产权进行质押等，合计不超过3.00亿元人民币。监事会和独立董事出具了同意意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》及《关于公司及子公司分别向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款提供担保的公告》。

近期公司与杭州银行股份有限公司科技支行就抵押质押贷款签署了《借款合同》、《最高额抵押合同》、《最高额质押合同》，并办理了抵押质押手续。具体情况如下：

一、借款合同签署情况

借款金额：捌仟万元整

借款期限：自2019-11-19至2021-04-15止

借款种类为：基本建设投资贷款

借款用途为：用于项目基建付款等

二、土地使用权抵押情况

公司已于2019年11月21日在杭州市规划和自然资源局办理了抵押登记备案手续。

抵押标的：公司名下位于杭州市滨江区西兴街道月明路与规划桂子路交叉口东南角的工业用地（不动产权证书号：浙（2017）杭州市不动产权第0273590号）

抵押权人：杭州银行股份有限公司科技支行

抵押人：杭州迪普科技股份有限公司

三、专利权质押情况

公司已于 2019 年 11 月 22 日在国家知识产权局办理质押登记备案手续。

质押标的：公司名下发明专利（专利号：ZL201610460465.4）

质权人：杭州银行股份有限公司科技支行

出质人：杭州迪普科技股份有限公司

上述资产的抵押及质押不会对公司的生产经营产生影响。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司董事会

2019年11月26日